



CAD/CAM用高透光性セミンタージルコニアディスク
松風ディスク ZR ルーセント スープラ

▲ S-WAVE

厚さ 12・16mm が登場

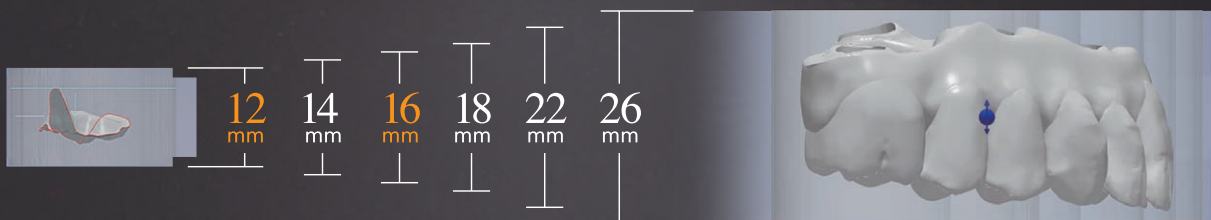
症例に適したサイズを選択することで**切削体積を軽減し、**
材料の無駄を省くとともに**作業時間を短縮**します。

短時間焼結
スケジュールを
 追加しました。

詳細は裏面へ



インレーから高さのあるインプラント症例まで幅広く対応



SHOFU INC.

トリプルグラデーション技術

「松風ディスク ZR ルーセント スープラ」は、松風独自のトリプルグラデーション技術により、『強度』×『透光性』×『色調』を機能的にディスク内に配置しました。「ディスク1枚」でインレー、ラミネートベニアからロングスパンブリッジまで幅広い症例に対応可能です。

エナメル層

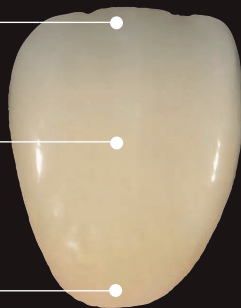
前歯部にも対応可能な高い透光性

ボディー層

層の界面が識別されにくい、すぐれたグラデーション機能

サービカル層

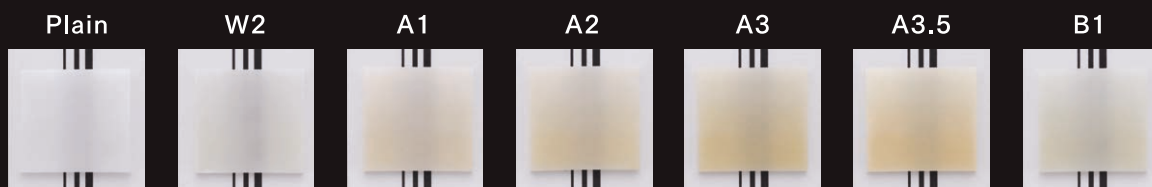
歯頸部の遮蔽性向上と、ロングスパンブリッジにも対応可能な高い強度



3点曲げ強さ ※1 (代表値)	可視光透過率 ※2 (代表値)	ディスク層
1034MPa	44%	エナメル層 30%
1163MPa	40%	ボディー層
1454MPa	37%	サービカル層 35%

※1 3点曲げ強さ (ISO 6872:2015に準ずる)
※2 可視光透過率 (JIS R 3106:2019に準ずる、色調:A2、試験体厚さ:0.5mm)

『5層マルチレイヤリング構造』によるすぐれた色調再現性



※ 印刷のため実際の色調とは異なる場合があります。

単冠～3歯ブリッジの場合、約5.8時間の短縮が可能に

■ 推奨焼結スケジュール メタコネクターを使用する場合には、加工物を縦置きにして焼結してください。

	昇温速度	焼結温度・係留時間	降温速度	総焼結時間
焼結スケジュール 1 (標準)	室温～1450℃ …… 5℃/分～10℃/分	1450℃・120分	炉内放冷又は5℃/分～10℃/分にて降温	約8.7時間 ※3
焼結スケジュール 2 短時間	①室温～1000℃ …… 60℃/分 ②1000℃～1450℃ …… 10℃/分	1450℃・90分	①1450℃～1000℃ …… 40℃/分 ②1000℃～250℃ …… 60℃/分	約2.9時間 ※4

※3 室温 (30℃) ～1450℃:5℃/分昇温、1450℃120分係留、1450℃～250℃:10℃/分降温の場合。

※4 「オストロマット 674i」を用いて降温プログラムを使用した場合。

焼結スケジュール2を
ご使用される際の注意点

- ・焼結スケジュール1と2では、焼結後の色調に差が出る場合があります。
- ・2段で焼結すると焼結台が割れる可能性があるため、必ず1段で焼結してください。
- ・焼結スケジュール 2の適応症例は単冠～3歯ブリッジまでです。

**短時間焼結スケジュールを
追加しました。**

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ディスク ZR ルーセント スープラ	歯科切削加工用セラミックス	管理医療機器 医療機器認証番号 229AGBZX00044A05

ご使用の際は電子添文をよく読んでお使いください。

包装

松風ディスク ZR ルーセント スープラ

12mm 18mm
14mm 22mm
16mm 26mm

【サイズ】 6種類: φ98×12, φ98×14, φ98×16,
φ98×18, φ98×22, φ98×26(mm)

【色調】 7色: Plain, W2, A1, A2, A3, A3.5, B1



取扱い店